

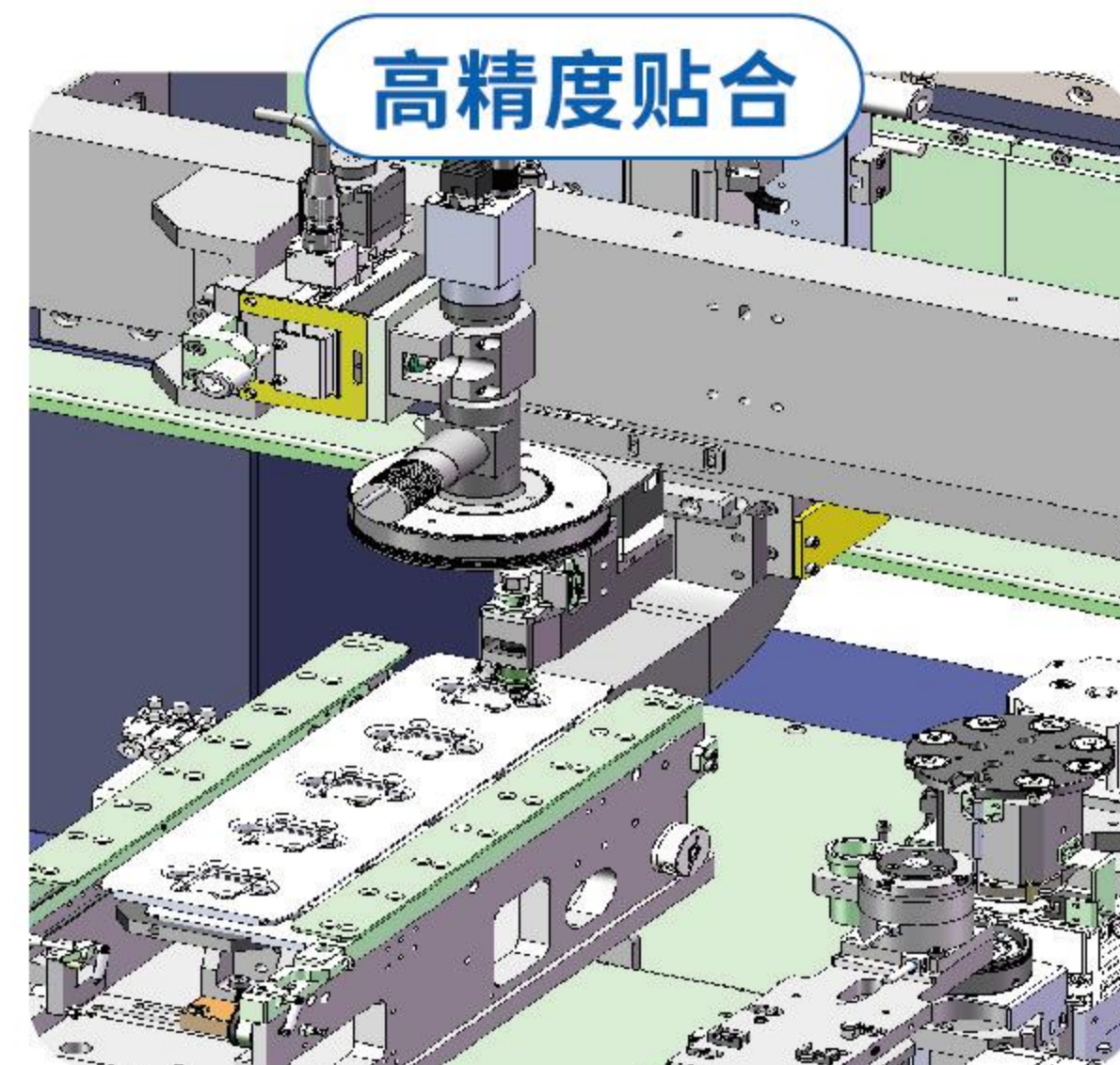
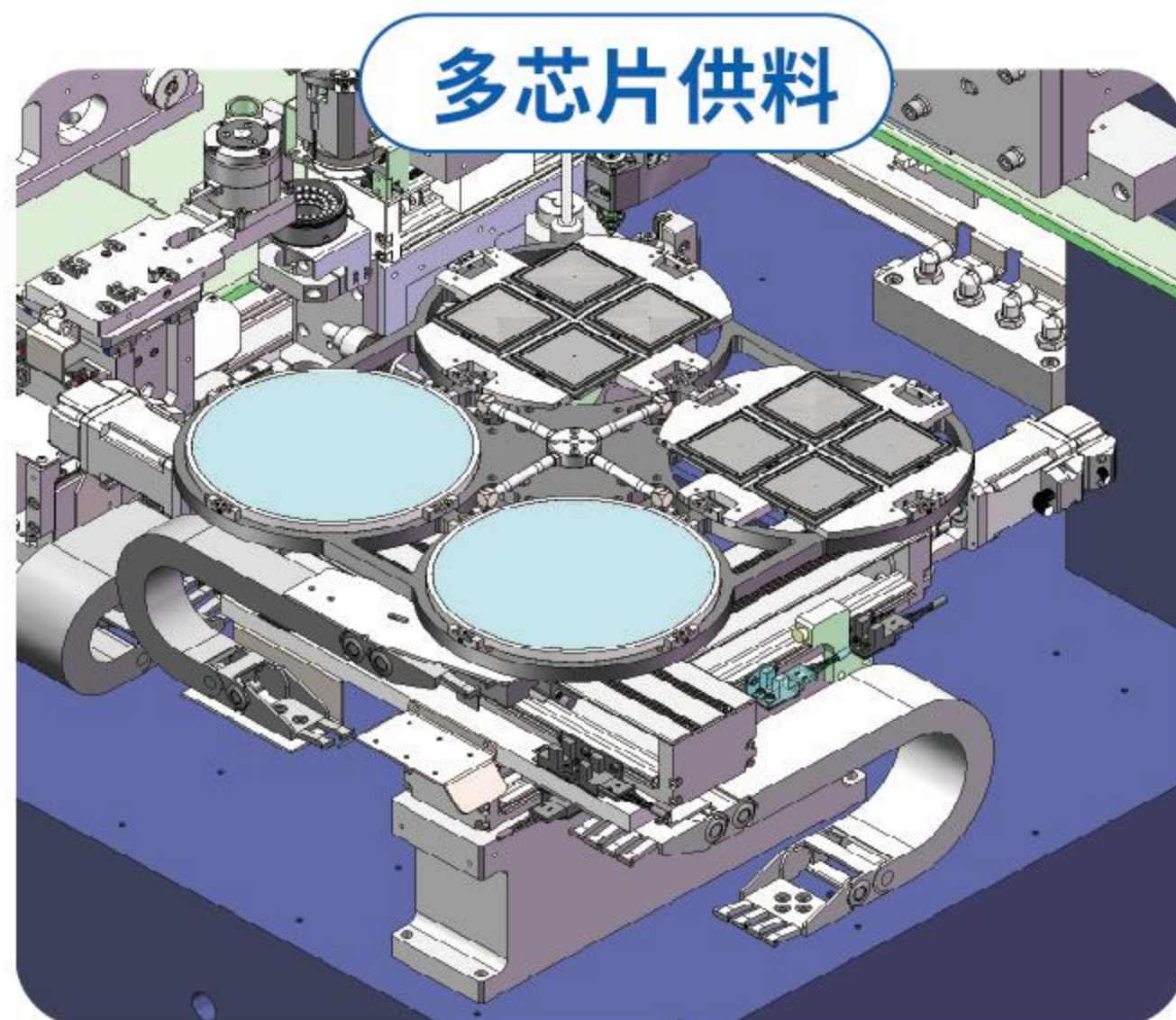
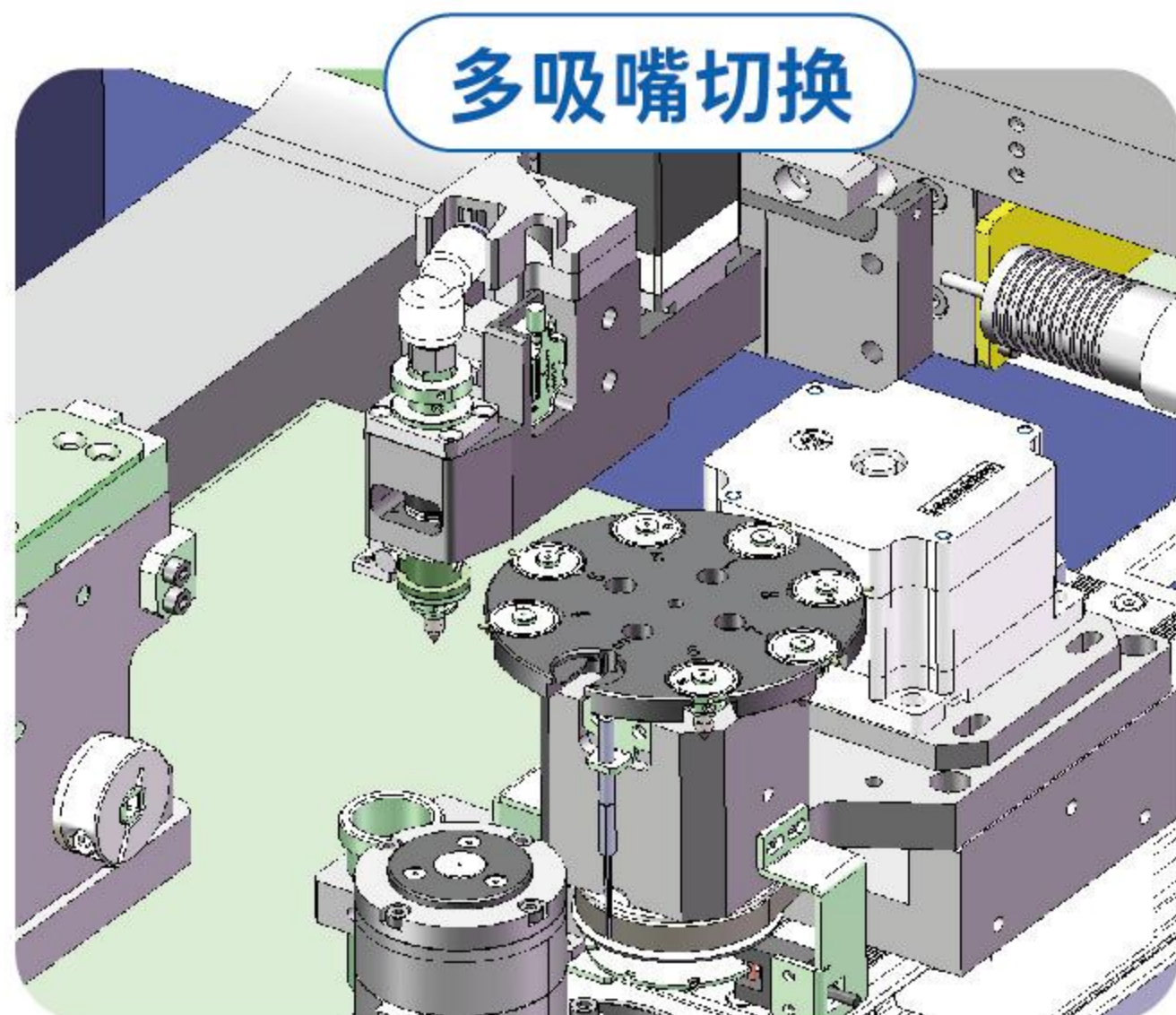
DB-150A

多芯片自动固晶机



产品特性

- 高精度贴装 $\pm 3\mu\text{m}$
- 灵活的材料处理能力：
 - 最多支持4个6寸晶圆环
 - 可选Waffle Pack、Gel-Pak, 或定制夹具
- 适用于COB、BOX等光器件和传感器的多芯片混合贴装
- 支持最多4种吸嘴自动更换
- 支持点胶和画胶系统共存



性能参数

序号	项目	指标
01	贴片位置精度	$\pm 5\mu\text{m}$ @3 sigma $\pm 3\mu\text{m}$ (标准片)
02	贴片角度精度	$\pm 0.3^\circ$ @3 sigma
03	贴合压力	10gf~200gf(可编程)
04	单颗贴合时间	≤ 6 秒
05	点胶系统	蘸胶或画胶
06	顶针系统	1套
07	上料系统	6寸扩晶环4个
08	视觉校准系统	3套下视+1套上视相机 可选RGB三色光源
09	贴片尺寸	最小:0.12mm*0.12mm; 最大:5mm*5mm
10	基板载具尺寸	宽度:50~100mm; 长度:50~200mm
11	上料/下料料盒	2个
12	电源	200-240VAC, 50-60Hz, 3000W
13	气源	压缩空气: 0.5~0.6Mpa / 真空: -60~-80KPa
14	外形尺寸	1240mm(L)x1160mm(W)x1830mm(H)
15	重量	1200kg